# 鉄中の溶質・不純物原子の拡散における電子線照射効果の解明 Study on Electron Irradiation Effects on Solute/Impurity Diffusion in Iron

外山健#,A),永井康介 A),井上耕治 A),吉田健太 A),南雲一章 A),下平昌樹 A),C.ZhaoA)

Takeshi Toyama<sup>#,A)</sup>, Yasuyoshi Nagai<sup>A)</sup>, Koji Inoue<sup>A)</sup>, Kenta Yoshida<sup>A)</sup>, Kazuaki Nagumo<sup>A)</sup>, Masaki Shimodaira<sup>A)</sup>,

Can Zhao A)

<sup>A)</sup> Institute for Materials Research, Tohoku University

## Abstract

Irradiation-enhanced diffusion of copper in iron matrix was investigated by using three-dimensional atom probe. The irradiation devise for high-temperature irradiation at the  $1^{st}$  accelerator in QST Takasaki has been modified to enable three condition of irradiation temperature simultaneously. Diffusion-couples of copper-iron system and iron-copper dilute alloys were electron irradiated at 250 - 620 C, and then analyzed by three-dimensional atom probe. An enhancement in diffusivity of copper in iron by electron irradiation was observed below 570 C. The enhancement mechanism is discussed by using reaction equations.

Keyword: radiation enhanced diffusion, reactor pressure vessel, three-dimensional atom probe

# 1. はじめに

原子炉圧力容器(reactor pressure vessel: RPV)は、 核燃料や一次冷却水を保持する大型の容器である。 RPVは、充分な安全裕度をもった健全性の確保が必要な構造部材であり高靱性の鋼材を用いて造られているが、長期間の原子炉運転中には炉心からの中性 子照射によって脆くなってしまう(RPV 鋼の照射脆化)。脆化の主因として、不純物元素である銅や溶 質元素であるニッケル、マンガン等の微細析出物が知られている。この微細析出物の形成を理解するう えで、溶質・不純物原子の拡散係数は重要なパラメ ータであり、例えば、我が国の現行の予測式にも銅の拡散係数が入っている。

RPV 鋼の照射脆化研究で最も重要な鉄中の銅の拡 散係数に関しては、従来は電子プローブ微小部分析 法や放射性同位元素を利用した順次切削法などを用 いて測定されているが、これら手法の位置分解能の 限界から数µm-数10µmといった大きな拡散長が 必要だった。そのため、拡散係数の直接測定は700℃ 以上の高温領域に限られていた。これに対して、3 次元アトムプローブ (three-dimensional atom probe: 3D-AP) を利用すればわずか数 10nm-数 100nm の拡 散長で十分であり、従来よりも大幅に低い温度領域 で拡散係数を直接測定することが期待できる。これ は、RPV 鋼の使用温度である 300℃程度までの外挿 をする際の精度と信頼性を向上させる上で重要であ る。そこで、我々はこれまでに、純 Fe 中および RPV 実用鋼中における拡散係数および析出物形成の駆動 力を考える上で重要な固溶限濃度を 3D-AP 測定から 求めてきた[1,2]。

ところで、原子は原子空孔や格子間原子を介して 拡散するから、それらが大量に導入される照射下で は、一般に拡散が大きく促進される(照射促進拡散) [3]。照射促進効果は計算機シミュレーションや反応 速度論などでモデル計算されてはいるが、実験的な 研究例は未だほとんど報告されていないのが現状で ある。そこで、本研究では、QST 高崎研1号加速器 を用いて基礎的な照射効果を評価可能なフレンケル 対を導入し、電子線照射した鉄試料における溶質・ 不純物原子(特に銅原子)の拡散を 3D-AP で観察す る。これにより、熱時効の結果と比較することで照 射促進効果を分離して、照射促進拡散を定量的に評 価しようとする。また照射下における固溶限濃度も 求める。

鉄中の溶質・不純物原子の拡散係数は室温付近で は極めて小さい。そのため、測定可能な拡散長を得 るためには、試料をある程度の高温に保持した状態 で電子線照射する必要があるものと考えられる。そ のため、試料 (5mm×5 mm×1 mm程度、10 枚程度) を真空中で 200-600℃程度に保持し、電子線照射 (2MeV、数時間)を行う。照射試料は、通常の拡散 実験にならい、高純度鉄を母材として銅を接合させ た拡散対とする。照射後、東北大金研大洗施設にて 3D-AP 測定を行い、拡散対界面からの銅原子濃度プ ロファイルを求め、拡散係数および固溶限濃度を評 価する。なお、500℃以下の温度では、鉄中の銅の固 溶限濃度が非常に低くなり、3D-AP 測定における検 出限界濃度(鉄中の銅の場合、おおよそ 0.05wt.%程 度)よりも低くなる可能性が考えられる。その場合、 銅の濃度プロファイルを測定できず、拡散係数を評 価できない恐れがある。そこで、鉄中の銅の析出挙 動から拡散係数を評価することを考え、鉄ー銅2元 系希薄合金(Fe-1.0wt.%Cu 合金)も上記と同様にし て電子線照射する。これらにより、鉄中の銅の拡散 に対する電子線照射効果を調べることを今年度の目 的とする。

# 2. 試料および電子線照射

# 2.1 試料

銅-鉄拡散対について、母材として純鉄(5N)を

# [17007]

用い、約5mm×5mm×1mmの板状に切断し、試料 表面を研磨紙#2000まで機械研磨した。化学研磨で 機械加工層を十分に除去した後、直ちに試料を $10^5$ Pa以下まで真空引きした。さらに、真空チェンバー 内にてアルゴンガススパッタリングを施し試料表面 を清浄にした後、銅を数 $\mu$ m 蒸着した。銅の溶解は 電子ビーム加熱で行なった。蒸着源である銅は純銅 (5N)を用い、予め硝酸 5%で化学研磨を行い、表 面の酸化層を十分に除去しておいた。銅の蒸着厚は、 本実験で期待される拡散距離(数 100nm)に対して 十分な大きさである。

鉄-銅2元系希薄合金について、上記と同様の高 純度鉄および銅をアーク溶解し、約5mm×5mm×1 mmの板状に切断し、化学研磨で機械加工層を十分 に除去し表面を清浄にした。石英管に真空封入して 825℃で4時間保持し、氷水中に焼き入れた。焼き入 れ後、再度化学研磨して表面を清浄にした。一部の 試料は電子線照射し、残りの試料は電子線照射はせ ず熱時効した。熱時効条件について、時効温度は照 射温度と同一、時効時間は照射時間と同一とした。

### 2.2 照射

高崎研1号加速器にて電子線照射(2 MeV)を行った。電子線フラックスは約3.7×10<sup>13</sup> e/cm<sup>2</sup>/s であり、はじき出し照射率は約1.3×10<sup>-9</sup> dpa/s である。前年度(平成28年度)までに本課題の中で開発した照射装置を用いて照射した。照射温度および照射時間は、250℃×32400秒、310℃×32400秒、390℃×32400秒、475℃×32400秒、550℃×32400秒、570℃×14400秒、620℃×7200秒である。目標温度の±3℃以内で照射を行なった。試料の酸化を防ぐため、高純度へリウムガス雰囲気で照射した。

# 3. 3D-AP 測定

3.1 3D-AP 測定用の試料作製

電子線照射された試料を集束イオンビームで加工 し、3D-AP 測定用の針状試料を作製した。拡散対で は、銅-鉄界面を含むような試料とした。

## 3.2 3D-AP 測定結果(拡散対)

図1に、電子線照射された拡散対試料の銅および 鉄のアトムマップをそれぞれ示す。測定領域の先端 領域ではほぼ銅のみが検出されており、銅蒸着膜領 域からの 3D-AP 分析を行えていることが分かる。銅 は、銅-鉄界面を通して鉄母材に拡散していること、 界面から離れるにしたがって銅原子の濃度が低くな ることが分かった。また、銅への鉄の拡散も観察さ れた。鉄は銅の中で析出しているように見られた。

図2に、各照射温度で照射された拡散対試料にお ける銅濃度プロファイルを示す。銅-鉄界面からの 銅拡散が観察された。なお、500℃照射では、銅濃度 は非常に低く、3D-AP 測定における検出限界程度で あった。これは、銅の固溶限濃度が低いためと考え られる。



Figure 1. Atom maps for Cu, Fe, C, N and O in the electron-irradiated Cu-Fe diffusion pair. The electron irradiation condition is at 620C for 2 hours.



Figure 2. Cu concentration profiles in the electron-irradiated Cu-Fe diffusion pair.

### 3.3 3D-AP 測定結果(Fe-Cu 合金)

図3に、電子線照射された Fe-Cu 合金および熱時 効された Fe-Cu 合金の銅のアトムマップをそれぞれ 示す。550℃および 475℃で熱時効された試料では、 銅析出物が明瞭に観察された。一方、390℃および 310℃で熱時効された試料では、銅原子の分布はほぼ 一様であり銅析出物は観察されなかった。電子線照 射された試料では、いずれの照射温度でも銅析出物 が明瞭に観察された。250-475℃では、銅析出物の寸 法や数密度には大きな差異は見られなかった。550℃ では、250-475℃に比べて、析出物の寸法が大きく、 析出物の数密度は小さかった。

#### 電子線照射 熱時効 550°C . 9h . 1995 Carlos 475°C And Andrews 9h 390°C 9h 310°C 2 9h 10nm A State of the 250°C 9h

Figure 3. Atom maps for Cu in the electron-irradiated or thermally-aged Fe-1.0wt.%Cu alloys.

# 4. 拡散係数の導出

4.1 銅濃度プロファイルからの拡散係数の導出

図2に示した銅濃度プロファイルから銅の拡散係 数および固溶限を求める。非定常状態の拡散に対し ては Fick の第2則が成り立つが、拡散係数Dが濃度 に依存しない場合、以下の式が得られる。

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot ( \vec{\mathfrak{I}} 1 )$$

ここで、cは銅濃度、tは拡散時間、xは距離である。本研究で作製した銅-鉄拡散対は、銅の膜厚が 拡散長に対して十分厚いため、無限に銅を供給できると考えられる。このような半無限の拡散対での(式 1)の境界条件は、t=0でc=0( $0 \le x \le \infty$ )、t>0で  $c = c_0$  ( $c_0$ はx = 0の銅濃度で、固溶限濃度を与える) となる。このときの(式 1)の解は、

 $c(x,t) = c_0 \{1 - erf(x/2\sqrt{Dt})\}$ ....(式2)

となる。ここで、*erf*はガウスの誤差関数である。 (式2)を、Dおよび *c*<sub>0</sub>をフィッティングパラメータ として図2に適用した。なお、500℃照射した試料で は、鉄中の銅濃度が非常に低かったため、フィッテ ィングは行えなかった。

#### 4.2 銅析出挙動からの拡散係数の導出

図3に示した銅析出物の形成カイネティクスから 銅の拡散係数を求める。鉄中に銅析出物が存在し析 出物が成長するとき、成長過程は銅の拡散によって 支配されると考えると(図4)、拡散係数Dは下記 の式によって表される[4]。

なお、

$$R_{S} = \left(\frac{3}{4\pi}\frac{1}{N}\right)^{\frac{1}{3}} \quad x = \left(\frac{C_{M0} - C_{M}}{C_{M0} - C_{I}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

である。ここで、Nは銅析出物の数密度、 $c_M$ は鉄マ トリックス中の銅濃度、 $c_{M0}$ は析出前の鉄マトリック ス中の銅濃度、 $c_P$ は析出物中の銅濃度、 $c_I$ は析出物 とマトリックス界面における銅濃度、tは拡散時間で ある。N、 $c_M$ 、 $c_{M0}$ 、 $c_P$ は 3D-AP 測定から得られる値 を用いた。 $c_I$ も 3D-AP 測定から直接得られるはずだ が、3D-AP 測定の位置分解能の限界のため、 $c_I$ を精 度良く求めることは困難であった。そこで、今回は その温度での銅固溶限濃度を $c_I$ とした。tは照射(熱 時効)時間とした。



Figure 4. Illustrative drawing for the kinetics of Cu precipitation.

### 4.3 拡散係数の Arrhenius プロット

図5に、上記の方法によって得られた鉄中の銅の 拡散係数を Arrhenius プロットで示す。参考のため、 熱時効した場合の拡散係数(Rothman, 1968、Salje, 1977、Toyama, 2014) も併記する。電子線照射下の 拡散係数は、620℃の比較的高温の条件で



Figure 5. Diffusion coefficient of Cu in Fe.

# [17007]

は、熱時効の場合とほぼ同一だった。すなわち、照 射効果はほとんど見られなかった。一方、570℃では 熱時効の場合の約 10 倍の値が得られた。これより、 低温では照射によって拡散が促進されることが明ら かになった。さらに低い温度である 475℃では、拡 散係数は熱時効の場合よりもはるかに高くなること が明らかになった。390℃、310℃、250℃での拡散係 数は、475℃の場合のそれと比較してほぼ同一である ことが分かった。

本研究での電子線照射条件下で存在する原子空孔 濃度を反応速度論的に計算した。結果を図6に示す。



Figure 6. Diffusion coefficient of Cu in Fe estimated by reaction kinetic model.

本実験結果は、原子空孔の sink (一般的には、転 位や粒界などが想定される)の濃度が非常に高いと 仮定すると反応速度論的な計算で良く表されること が分かった。この場合、本研究で観察された照射効 果は原子空孔濃度から説明できる可能性を示唆して いる。これを検討するためには、異なる原子空孔導 入速度での実験が有用と考えられる。今後、電子線 フラックスを変化させた実験を行ない、今回の実験 結果と合わせて、鉄中の銅拡散に対する電子線照射 効果の機構を明らかにしていく。

### 5. まとめ

昨年度までに開発した、QST 高崎研1号加速器用 の高温電子線照射チェンバーを利用して、250-620℃ で銅ー鉄拡散対おびよひ Fe-1.0wt.%Cu 合金を電子線 照射し、3D-AP 測定によって銅の濃度プロファイル および銅の析出挙動を調べ、鉄中の銅の拡散に対す る電子線照射効果を調べた。570℃以下では照射によ って拡散が促進されることが分かった。その程度は、 530℃で熱時効下の約 10 倍であった。今回の実験時 要件では、475℃以下では照射下の拡散係数はほぼ一 定となることも分かった。今後、異なる電子線照射 条件(特にフラックス)での実験を行ない、照射効 果の機構を明らかにする。

# 参考文献

- [1] T. Toyama, F. Takahama, A. Kuramoto, H. Takamizawa, Y. Nozawa, N. Ebisawa, M. Shimodaira, Y. Shimizu, K. Inoue, Y. Nagai, The diffusivity and solubility of copper in ferromagnetic iron at lower temperatures studied by atom probe tomography, Scr. Mater. 83 (2014) 5-8.
- [2] M. Shimodaira, T. Toyama, F. Takahama, N. Ebisawa, Y. Nozawa, Y. Shimizu, K. Inoue, Y. Nagai, Diffusivity and Solubility of Cu in a Reactor Pressure Vessel Steel Studied by Atom Probe Tomography, Mater. Trans. 9 (2015) 1513-1516.
- [3] R. Sizmann, The effect of radiation upon diffusion in metals, J. Nucl. Mater. 69&70 (1968) 386-412.
- [4] J. Burke, The kinetics of phase transformations in metals, Pergamon Press (1965), page 162 – 169.